

证券代码：002008

证券简称：大族激光

## 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025006

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 投资者关系<br>活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）<br><input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 |  |
| 参与单位名称<br>及人员姓名   | 摩根大通（6月4日）<br>国寿安保基金（6月5日）<br>长江证券策略会（6月6日）<br>甬兴证券（6月10日）<br>Jefferies（6月18日）<br>易方达基金（6月19日）<br>M&G Investment Management(UK)（6月20日）<br>高盛证券（6月25日）<br>中信建投（6月25日）<br>天风证券策略会（6月26日）<br>申万宏源（6月26日）                                                                                                                                |  |
| 时间                | 2025年6月4日~2025年6月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 地点                | 公司会议室<br>成都群光君悦酒店<br>上海浦东香格里拉大酒店                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 上市公司<br>接待人员姓名    | 管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚<br>证券事务代表 王琳                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 投资者关系活动<br>主要内容介绍 | <p>一、公司的核心竞争力与优势</p> <p>公司秉承“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，聚焦于智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售，是全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商。公司经过二十多年的发展，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势、产业政策支持优势、综合技术优势、销售和服务网点优势、客户资源优势、品牌效应优势等。国内装备制造行业竞争激烈，公司通过精细化管理，能够将上述优势转化为公司业绩持</p>                                                                                                      |  |

续增长的动力。

## 二、公司新能源领域业务情况

锂电设备行业的增长重点逐步由国内转向海外，公司在深化大客户合作的同时，积极拓展海外市场业务。公司持续推进与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、海辰储能、蜂巢能源等行业主流客户的合作，积极参与到大客户出海的进程中，抓住新能源市场发展的全球化发展机遇，进一步提升动力电池和储能电池装备业务的市场竞争力和市场占有率，并通过加强创新技术研发和精细化管理等多种方式，持续提升盈利能力。

光伏设备方面，受行业景气度影响，下游客户资本开支明显减少，对公司相关设备订单造成一定影响。公司在主流电池厂家取得主制程设备（PECVD、LPCVD、硼扩散炉、退火炉等）批量订单，并与主流客户共同开发验证电池生产工序核心装备。同时，公司加快海外业务的拓展步伐，中标客户在老挝等地订单。在钙钛矿技术领域，公司持续优化钙钛矿激光刻划相关设备工艺及性能，在该细分领域市场占有率处于领先地位，与极电光能、协鑫光电等行业头部客户保持良好合作关系。

## 三、公司半导体领域业务情况

公司在半导体领域主要为客户提供相关智能制造装备，主要产品为激光表切、全切设备，激光内部改质切割设备等前道晶圆切割设备；焊线设备、固晶设备、测试编带设备等后道封测设备以及晶圆自动化传输设备，用于半导体的生产加工环节。另外，公司所属子公司深圳市大族封测科技股份有限公司主要产品为半导体及泛半导体封测专用设备，目前仍在持续放量，正在推进和实现国产替代。

## 四、通用工业激光加工设备市场复苏情况

随着激光切割行业竞争激烈，市场格局日新月异。面对外部复杂环境，公司坚持研发创新，紧密围绕客户及市场需求，不断优化升级产品；坚持爆品打造，实现产品的大规模市场推广与销售放量；同时，严格坚守质量底线，坚持以质量为本。公司自主研发的三维五轴切割头取得突破，首年销售额突破 5,000 万，实现了广泛的国产替代，普遍应用于汽车行业热成型加工领域。公司推出了全球首台 150KW 超高功率切割机，扩大公司在高端领域的市场影响力。与浙江鼎力、东南网架、中国石油、爱玛科技等客户达成合作，在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上持续取得进步。另一方面，根据市场需求，加大对中低端市场的覆盖和拓展，高功率激光切割设备整体市占

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>率稳步提升。</p> <p><b>五、公司海外布局发展情况</b></p> <p>当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，东南亚地区设备需求呈明显上升趋势，公司正大力扩充海外研发销售团队人员，紧跟大客户的步伐，抓住供应链多元化带来的市场机会。在 PCB 海外市场方面，由于国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目纷纷投产，预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业链的重构，美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC 封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3%及 40.6%。</p> <p><b>六、公司回购完成情况</b></p> <p>公司于 2025 年 2 月 6 日披露《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,589,592 股，占公司总股本的比例为 2.15%，支付的资金总额为人民币 500,244,727.76 元（不含交易费用）。本次回购已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日。</p> <p>公司于 2025 年 5 月 13 日披露《注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司股份回购专户中的 22,589,592 股，由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”，公司总股本将由 1,052,193,000 股减少至 1,029,603,408 股，该等股份将于近期完成注销。</p> <p><b>七、公司质押情况</b></p> <p>目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 75.98%。</p> |
| 附件清单<br>(如有) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日期           | 2025 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |